

16:00 Uhr **Pause**

16:30 Uhr **Die Vielseitigkeit der flexiblen Leiterplatte**
Dr. Sebastian Schweiger; Qualitätsmanager
Dyconex AG, CH-Bassersdorf

Die immer weiter fortschreitende Miniaturisierung stellt hohe Anforderung an die Leiterplatte, vor allem für medizinaltechnische Anwendungen. Flexible Leiterplatten erlauben durch Faltung das zur Verfügung stehende Volumen optimal auszunutzen. Zusätzlich erlaubt die Integration von Komponenten und Funktionalitäten eine weitere Platzeinsparung. Dünne Materialien und ein feines Leiterbild bieten vielfältige Möglichkeiten die Systeme weiter zu verkleinern, stellen aber zugleich grosse Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Leiterplatte.

17:00 Uhr **s.mask – die digitale, additive Revolution der Lötstopmmaske**
Markus Knausenberger; Manager Technologie & Verfahren
FELA GmbH, D-Villingen-Schwenningen

Seit Ende 2019 fertigt die FELA GmbH s.mask in Serienreife. Mittlerweile ist fast die Hälfte der ausgelieferten Leiterplatten bei FELA mit der innovativen Lötstopmmaske ausgestattet. Das Kundenfeedback ist durchweg positiv, und die Einsparungen sowohl ökologischer, als auch ökonomischer Natur sind bereits spürbar. Parallel forscht FELA an weiteren Techniken und alternativen Tinten, um kurzfristig die gesamte Produktion auf s.mask umstellen zu können. Der Vortrag zeigt die aktuellen Entwicklungen und gibt einen Ausblick in eine mögliche additive Zukunft der Leiterplattenfertigung.

17:40 Uhr **Schlusswort**

17.45 Uhr **Apéro mit anschliessendem Nachtessen**
und gemütlichem Beisammensein

Wir möchten Sie bitten, die geltenden Corona-Regeln während der Veranstaltung einzuhalten.

Einladung



**Schweizerische Gesellschaft
für Oberflächentechnik
Société Suisse de Traitement
de Surface**

ZUM TRADITIONELLEN SGO- LEITERPLATTENSEMINAR

22.09.2021

Nach über zwei Jahren «Corona-Abstinenz», freuen wir uns sehr, Sie zum traditionellen SGO Leiterplattenseminar einzuladen.

Einen abwechslungsreichen Nachmittag mit spannenden Vorträgen zu Trendthemen erwarten Sie. So zum Beispiel Erläuterungen zu SAP, Flex-Leiterplatten und s.mask für smarte Elektronik und Miniaturisierung.

Im Namen des OK's wünschen wir allen Beteiligten eine interessante und spannende Veranstaltung mit vielen Kontakten und wertvollen Anregungen im Kreise der Schweizerischen und Süddeutschen Leiterplatten-Familie.

Datum: Mittwoch, 22. September 2021

Zeit: 13:30 Uhr

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus,
im Spilhöfler
8142 Uitikon ZH
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Kosten: Inkl. Kaffee, Apéro + Nachtessen
(ohne Getränke)

Nur Tageskasse SGO Mitglieder Fr. 70.-
Nichtmitglieder Fr. 110.-

Anmelden unter: www.sgo-sst.ch - Fachanlässe

Programm

13:30 Uhr **Begrüssung**
Hr. Peter Weber, Head of Technology
GS Swiss PCB AG, CH-Küssnacht

Marktanalyse Europa / speziell D / A / CH
Hr. Remo Fischer; Betriebsleitung
Hofstetter PCB AG, CH-Küssnacht

13:45 Uhr **Elektronik mit additiven Verfahren; aktueller Stand und ein Ausblick**
Dr. Jakob Heier; Group leader
Empa – Laboratory for functional Polymers, CH-Dübendorf

Gedruckte Elektronik als disruptive, wachsende Technologie, findet ihren Weg ins Produktdesign. Für prozess-etablierte Unternehmen kann die Integration derer eine Herausforderung sein, da neue Technologien einen Mehrwert aufweisen müssen. Die gedruckte Elektronik bietet eine Vielzahl an Vorteilen. Hoher Durchsatz, Biegsamkeit, Leichtigkeit, aber auch Leistungsmerkmale, wie Verfügbarkeit, Kosten oder Reife sind entscheidende Aspekte.

Sie erhalten einen Überblick über den jetzigen Stand der Technik und deren Anwendung mit passiven und aktiven Komponenten von der Leiterbahn bis zu Sensor-Einheiten.

Weiter werden Konsequenzen der additiven, relativ zu heutigen subtraktiven Fertigung diskutiert, wobei verwendete Hilfsmittel der Tinten miteinbezogen werden. Der Vortrag schliesst mit der Vorstellung verfügbarer Prozesse und umgesetzten Projekten im Coating Competence Center der EMPA, wobei verschiedene Kooperationsmodelle aufgezeigt werden.

14:30 Uhr **SAP Technologie (Semi-Additiv-Process); gestern Vision – heute Produktion**
Dr. Rodica Ababei; Process Engineering Manager
GS Swiss PCB AG, CH- Küssnacht

Die rasante technische Entwicklung unserer Zeit zwingt fast alle Technologie-Branchen in neue Dimensionen der Miniaturisierung. Übertragen auf die Leiterplatte sehen wir uns in diversen Applikationen wie Medizinaltechnik, Industriemesstechnik, Kommunikation, etc. mit stark steigenden Miniaturisierungsanforderungen konfrontiert. In diesem Zusammenhang ist die Herstellung von entsprechend miniaturisierten Leiterplatten ein komplexes Zusammenspiel zwischen bestehenden und neuen Prozesstechnologien. Die GS Swiss PCB AG hat in den letzten 3 Jahren die SAP-Technik vorangetrieben, implementiert und in robuste Produktionsabläufe umgewandelt. Hohe Investitionen in die Reinraumtechnologie sowie den Sputtering-Prozess waren u.a. notwendig, um Leiterbilder von 10 - 20 µm L/S produzieren zu können.

15:15 Uhr **Neue Nasschemische Verfahren, insbesondere Handling von dünnen Materialien**
Laurent Nicolet; Vice President
BU Electronics SCHMID Group, Hongkong

SCHMID wird die neue InfinityLine C+ vorstellen. Diese Maschine basiert auf einer Single-Panel-Bearbeitungskammer, die eine Verklebung der Panels verhindert. Es stehen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung: die Möglichkeit, mehrere Prozesse in der gleichen Kammer durchzuführen oder mehrere Kammern zu haben. Die gesamte Maschine ist so konzipiert, dass sie einer höheren Reinraumklasse (ISO6 oder ISO5) entspricht. Der Schwerpunkt wurde auf die Einsparung von Betriebsmitteln gelegt. Bis zu 70 % weniger Betriebsmittel im Vergleich zu einer Standardmaschine.